THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION ,1995.
© COPYRIGHT 1995 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

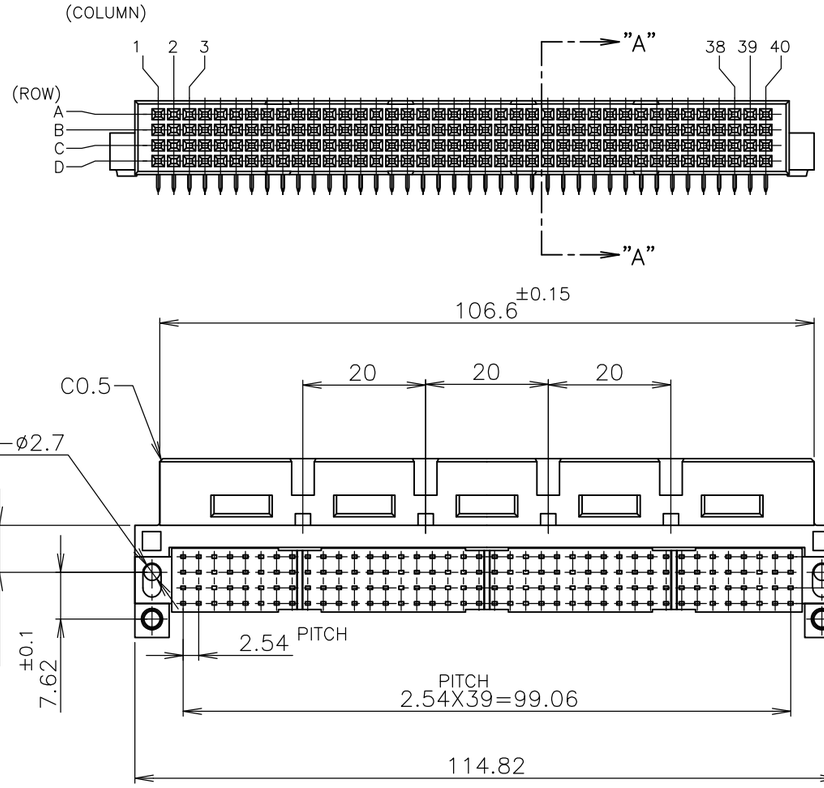
LOC	DIST
J	

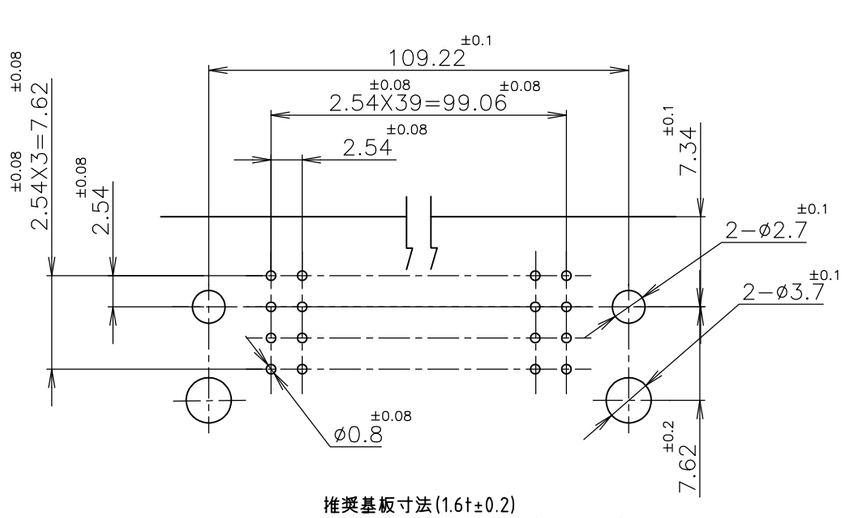
REVISIONS
??

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	REVISED FJB0-0213-03	11APR03	H.T	I.E
	A1	REVISED PER ECO-10-000443	18JAN10	KK	HMR

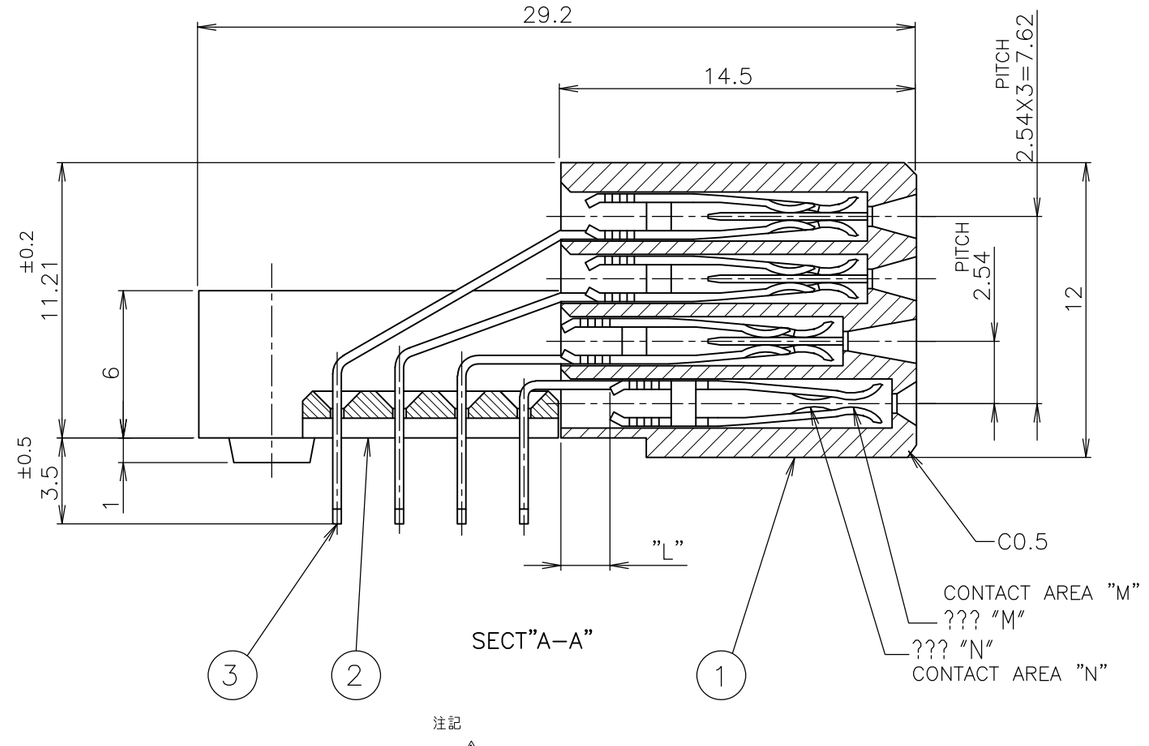
TYPE	DIM "L"	POSITION (ROW-COLUMN)
GROUND	2	A-1,40 B-1,40
BATTERY	1	A-5,6,35,36 B-5,6,35,36
SIGNAL	0	ALL OTHER

-1本図
(-1;AS SHOWN)





推奨基板寸法(1.6t±0.2)
RECOMMENDED P.C. BOARD DIM. (1.6t±0.2)



注記

⚠1 コンタクト仕上；
ニッケル下地メッキの上に接触部 "M" 側及び接触部 "N" 側 0.2 最少の金パラジュームニッケルメッキ
タイン部2.5μMAX.の錫メッキを施す。
⚠2 -2 はA, B, C列のみ挿入してある。
⚠3 -3 はA, B列のみ挿入してある。

NOTES

⚠1 CONTACT FINISH;Ni UNDER PL.
0.2μMIN. Au PALLADIUM-NICKL PL.
ON CONTACT "M" AND "N"
2.5μMAX.TIN PL. IN TINE AREA.
⚠2 -2 ; INSERT CONTACTS ROW W,B,C ONLY.
⚠3 -3 ; INSERT CONTACTS ROW A,B ONLY.
⚠4 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

⚠3	⚠4 OBSOLETE						
80	120	160	銅合金	COPPER ALLOY	リセ コンタクト	REC.CONTACT	3
1	1	1	熱可塑性ポリエステル樹脂(黒)	THERMOPLASTIC POLYESTER	サポート プレート	SUPPORT PLATE	2
1	1	1	熱可塑性ポリエステル樹脂(黒)	THERMOPLASTIC POLYESTER	リセ ハウジング	REC. HOUSING	1
-3	-2	-1	材料 / MATERIAL		名称 / NAME		No.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位： 粍 MM

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
0 PLC ± 0.3
1 PLC ± 0.3
2 PLC ± 0.3
3 PLC ± 0.3
4 PLC ± 0.3
ANGLES ±3°

MATERIAL 材料: SEE NOTE

FINISH 仕上: SEE NOTE ⚠1

DWN	H.AMIKURA	19APR95
CHK	T.SASAKI	21APR95
APVD	S.MANABE	21APR95
PRODUCT SPEC 製品規格		
APPLICATION SPEC 取付適用規格		
WEIGHT		

Tyco Electronics
Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki,Japan

NAME 名称: REC ASS'Y
S200 CONN. 0.2μ Au Pb-Ni

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A3	00779	C-917478	—

CUSTOMER DRAWING | SCALE 尺度 1:1 | SHEET 1 OF 1 | REV A1